2014 年 4 月 23 日

プレスリリース

eSilicon が DMP の Loputo インターコネクトを採用

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(本社: 東京都中野区、東証マザーズ: 証券コード 3652、代表取締役 CEO 山本達夫、以下 DMP)は、米国 eSilicon Corporation(本社: 米国サンノゼ、CEO Jack Harding、以下 eSilicon)が、DMP の SoC インターコネクト IP コア「Loputo インターコネクト」を採用したことを発表いたします。

DMP の Loputo インターコネクトは、スマートアービターを実装したユニークなスイッチングマトリックスアーキテクチャを採用した SoC インターコネクト IP コアです。高性能なバストランザクションを実現しながら、配線混雑を抑え、レイアウト時のタイミング収束を容易にする特長があります。IP コアサイズが、AMBA ベースの既存製品の1/2以下のため、チップの低コスト化にも貢献いたします。なお、Loputo インターコネクトは、AMBA と OCP の両方の標準バスプロトコルをサポートしておりますので、様々な AMBA ベースや OCP ベースのデザインにご使用いただくことが可能です。

eSilicon バイスプレジデント兼ジェネラル・マネージャー Gino Skulick 氏は次のように述べております。「我々の ASIC ビジネスは、多様なアプリケーションに展開しており、高い性能と品質に加えてコスト競争力が要求されます。様々なソリューションを評価した結果、DMP の Loputo インターコネクトが既存のインターコネクトよりも非常に優れていることがわかりました。また、DMP の製品が、我々の機能面や性能面に対する要求を満たしているだけでなく、彼らの高い技術力と日本のお客様からの厚い信頼も今回 DMP を選択した要因となりました。」

DMP 代表取締役社長 CEO 山本 達夫は、次のように述べております。
「今後市場が拡大する自動車運転支援システムなどで使用される半導体は、大量のデータや高度な演算処理を必要とすることから CPU、GPU、画像認識エンジンといった異種のプロセッサーを同時に効率よく動作させることが求められます。この際に重要なのはチップ内で各プロセッサーとメモリーをつなぎ、システムレベルで性能を最大限に引き出すインターコネクト IP です。Loputo は、DMP の長年にわたる GPU 技術の蓄積と高度な半導体開発技術をベースに開発されたユニークなインターコネクト IP で、従来のインターコネクト IP と比較し実装面積の大幅な削減を可能にし、低コスト、低消費電力で高いシステム性能の実現を可能にします。」

■eSilicon 社について

eSilicon は 2000 年に設立されたファブレスの半導体ベンダーです。eSilicon に関する詳細な情報

は、http://www.esilicon.com/ でご確認いただけます。

■株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)について

2002 年7月の会社設立以来、DMP(東証マザーズ: 証券コード 3652)は日本発のリーディング・テクノロジー・カンパニーとして、主に組込み市場向けに最適な 3D/2D 描画やコンピューティング目的の GPU 技術の開発を続けています。幅広い組込み製品をカバーするハード、ソフトを含む GPU ソリューションにより、新しいユーザー体験を提供する事を目指しています。また Khronos グループのメンバーとして OpenGL ES の仕様策定に主導的役割を果たしています。DMP に関する情報は http://www.dmprof.com/ で入手できます。

©2014 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル DMP、DMP ロゴは株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

本件に関するお問い合わせ

先株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 広報担当:梅田／IR 担当:伊藤

TEL:03-6454-0495 e-mail:info_06@dmprof.com

Web サイト: http://www.dmprof.com/contact/